

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

恒玄科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-9-8

投资者关系 活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（_____）
参与单位名称 及人员姓名	科创板 2026 年半年度芯片设计行业集体业绩说明会
时 间	2026 年 9 月 8 日
地 点	公司办公室
上市公司接待 人员姓名	总经理：赵国光 财务总监、董秘：李广平
投资者关系活 动主要内容介 绍	Q&A 1、消费电子需求偏弱，下半年订单恢复节奏如何？ 尊敬的投资者，您好！今年消费电子市场整体景气度下降，需求疲软。公司下游市场集中度和份额比较高，芯片销售和下游消费电子终端销售情况高度正相关，因此下半年主要还是要看行业景气度的变化。感谢您的关注。 2、AI 眼镜芯片业务，今年客户导入及量产进度怎样？ 尊敬的投资者，您好！公司 BES2800 系列芯片上半年成功导入雷鸟、Rokid 等智能眼镜领域重点新客户。公司新一代旗舰智能可穿戴芯片 BES6100 已顺利流片，下半年将进入测试及客户送样阶段，预计 2027 年进入量产阶段。感谢您的关注。 3、今年上游代工厂、封测、材料普遍上调价格，公司的产品价格调整情况是怎么样的？在应对供应链成本压力方面公司是怎么做的？ 尊敬的投资者，您好！存储涨价是全行业现象，由于 AI 算力需求挤占代工与存储产能，造成供需结构性错配，存储和代工价格上涨，造成

	整体成本的上涨，公司会根据上游成本的变动适时调整芯片价格。公司持续关注降本增效，和上下游供应链伙伴共同应对挑战。感谢您的关注。 4、可穿戴及智能硬件市场未来的成长趋势怎么样？有哪些新的增长机会？ 尊敬的投资者，您好！AI 技术的发展催生了端侧硬件市场的广阔机遇，可穿戴和智能硬件都在往更大算力的趋势上发展。公司长期深耕无线通信、智能音视频、低功耗 SoC 三大核心技术领域，未来将聚焦新一代智能音频、智能可穿戴及创新个人 AI 硬件赛道，以自研高性能芯片技术为核心根基，致力成为全球极具创新竞争力的行业领跑者。感谢您的关注。 5、请问 BES6100 芯片目前送样推进到什么阶段？已接触的客户类型与反馈如何？从送样到定点再到量产，公司预期的时间节奏是怎样？如何看待 2026-2027 全球 AI 眼镜出货的现实情况，以及公司产品的竞争优势？ 尊敬的投资者，您好！公司新一代旗舰智能可穿戴芯片 BES6100 已顺利流片，下半年将进入测试及客户送样阶段，预计 2027 年进入量产阶段。BES6100 芯片为混合异构系统的智能眼镜单芯片方案，兼顾高性能计算与超低功耗需求，实现多模态、多感官与全天候续航一体化，有效解决了传统智能眼镜双芯片方案中存在的芯片间通信复杂、系统设计难度大、PCB 面积大、成本高等问题。公司看好智能眼镜未来的成长，将持续投入并推出更多新产品。感谢您的关注。
附件清单	无
日 期	2026 年 9 月 8 日